

证券代码：603061

证券简称：金海通

公告编号：2026-016

## 天津金海通半导体设备股份有限公司

### 2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 2 月 5 日

(二)股东会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体设备股份有限公司上海分公司 M 层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                    | 171        |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 29,245,745 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 50.1942    |

注：有表决权股份总数指公司总股本剔除截至股权登记日公司 2025 年员工持股计划证券账户中的 1,734,770 股后的股份总数 58,265,230 股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事长崔学峰先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书刘海龙先生及其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对        |           | 弃权    |           |
|------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 27,383,924 | 93.6339   | 1,860,321 | 6.3610    | 1,500 | 0.0051    |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                                | 同意            |           | 反对            |           | 弃权    |        |
|----------|-------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|-------|--------|
|          |                                     | 票数            | 比例<br>(%) | 票数            | 比例<br>(%) | 票数    | 比例 (%) |
| 1        | 《关于使用部分<br>闲置自有资金<br>进行现金管理<br>的议案》 | 8,757,<br>061 | 82.4669   | 1,860,<br>321 | 17.5190   | 1,500 | 0.0141 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案1为普通议案，已获得出席会议的股东和代理人所持表决权股份总数的1/2以上通过；
- 2、本次股东会议案已对中小投资者单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

律师：彭瑶、季俊宏

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司董事会  
2026 年 2 月 6 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书